

「ハードウェアのシリコンバレー深セン」に学ぶ - これからの製造のトレンドとエコシステム (NextPublishing)



発売日: 2017年11月24日

出版: インプレスR&D

著者: 藤岡 淳一

ページ: 124

PDF

<http://yep.pm/OAhneCFd5/VSkCA0dRR.pdf.rar>